

科创板七周年:611家企业市值超13万亿元

24只千亿市值

开市七年,科创板上市公司扩容至611家。截至7月22日收盘,板块上市企业合计总市值超13万亿元。

七年发展历程中,科创板培育出寒武纪、中芯国际、海光信息、中微公司、华虹宏力等24家千亿市值上市公司。其中,寒武纪总市值位居板块首位,最新总市值约8230.64亿元;中芯国际紧随其后,总市值约7760.82亿元;海光信息总市值约7707.51亿元。中微公司、沐曦股份等8家企业总市值处于2000亿—4000亿元区间;联讯仪器、盛科通信等13只个股总市值处于1000亿—2000亿元区间。

从个股收盘价来看,A股股价前三席位均由科创板企业占据,依次为联讯仪器、源杰科技、寒武纪。截至7月22日收盘,联讯仪器报1888.08元/股,源杰科技报1415元/股,寒武纪报1310元/股。

7月22日晚间,联讯仪器发布公告,预计2026年半年度归属净利润5.1亿—5.8亿元,较上年同期增长801.96%—925.75%。

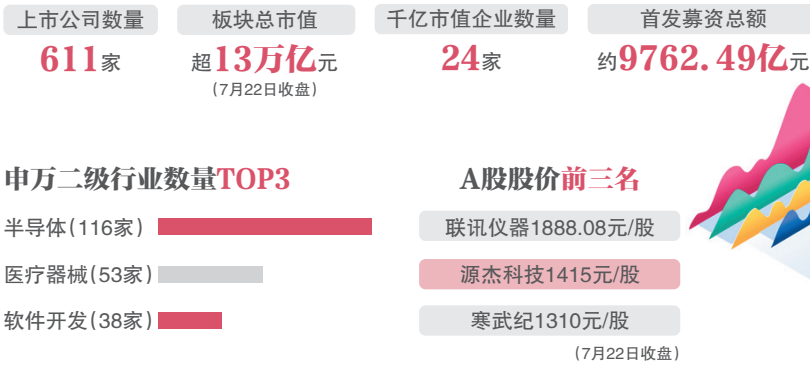
按照申万二级行业划分,科创板半导体企业数量居首,共计116家;医疗器械行业紧随其后,拥有53家上市公司;软件开发行业位列第三,共38家企业。

研发投入是衡量科创企业核心竞争力的重要标尺。同花顺iFinD数据显示,2025年科创板上市公司合计研发费用超1800亿元。细分来看,百济神州研发投入领跑全板块,全年研发费用达155.08亿元,也是板块内唯一一家研发费用突破百亿元的企业;此外,中芯国际、海光信息、时代电气等33家企业年度研发费用超过10亿元。

盈利能力方面,2025年中芯国际成为科创板盈利规模最大的企业,全年实现归属净利润约50.41亿元。紧随其后,时代电气、中国通号当年归属净利润分别约为40.97亿元、36.86亿元,两家企业净利均突破30亿元。除上述三家企业外,另有23家科创板上市公司全年净利润超10亿元。

7月22日,科创板迎来开市七周年。2019年7月22日,科创板正式鸣锣开市,首批25家上市公司登陆资本市场。截至目前,已有611家企业在科创板挂牌上市,板块合计总市值超13万亿元。纵观科创板个股成色,“硬科技”底色十足,2025年科创板上市公司合计研发费用超1800亿元。未来,科创板还将进一步扩容,同花顺iFinD统计显示,当前共有79家企业处于科创板IPO排队序列,存储芯片龙头长鑫科技已于7月16日启动新股申购,即将登陆资本市场。

科创板七年核心板块概况(截至7月22日)



业绩预告层面,目前已有56家科创板企业披露2026年上半年业绩预告。以预告净利润上限统计,50家企业预计实现盈利。其中,佰维存储上半年业绩表现突出,预计实现归属净利润70亿—75亿元,上年同期亏损2.26亿元,实现同比扭亏。

数据显示,上述611家科创板企业首发募集资金总额约9762.49亿元。值得关注的是,处于已发行待上市阶段的长鑫科技发行价定为8.66元/股。按照该发行价测算,若本次发行顺利完成,在超额配售选择权行使前,预计募集资金总额约579.19亿元,将刷新科创板IPO历史融资纪录。

79家企业排队IPO

除存量上市公司外,科创板IPO储备项目储备充足,当前共有79家企业处于IPO审核进程中。根据同花顺iFinD统计,从申报进度划分:

思朗科技、汇采医疗等11家企业处于受理阶段;同创普润、羲禾科技、上海隐冠等57家企业处于问询阶段;华盛雷达最新状态为上会暂缓审议;信诺维已提交注册;莱普科技、恒润达生、韬盛科技3家企业IPO处于中止状态。

与此同时,长鑫科技处于已发行待上市阶段;宇树科技、燧原科技、频准激光、国仪量子、高凯技术已完成注册生效,尚未启动发行。

从赛道分布观察,排队企业集中布局半导体、具身智能、商业航天等前沿硬科技领域。

在“国产GPU四小龙”中,摩尔线程、沐曦股份、燧原科技相继冲刺科创板,壁仞科技选择赴港上市。伴随燧原科技IPO拿到注册批文,“国产GPU四小龙”即将齐聚资本市场。成立八年来,燧原科技自主迭代四代架构、五款云端AI芯片,搭建起覆盖AI芯片、AI加速卡及模组、智算系统集群、AI计算编程软件平台的完整产品体系。

回溯燧原科技IPO历程:2026年1月22日申报获受理,2月11日进入问询,6月15日首发

会上获得通过,6月18日提交注册,7月9日取得证监会注册批复。本次IPO,燧原科技拟募集资金约60亿元。

具身智能赛道申报热度持续走高。7月2日,证监会公示信息显示,宇树科技科创板IPO注册生效。宇树科技也是科创板预先审阅机制下第二单IPO项目,闯关进程高效:自今年3月20日招股书获受理至注册生效,历时仅三个多月。

此外,具身智能机器人企业云深处同样申报科创板,IPO申请于5月18日获受理,公司主营四足机器人、轮足机器人等具身智能机器人研发、制造与产业化。

商业航天赛道同样迎来集中申报,蓝箭航天、微纳星空、中科宇航3家企业科创板IPO均进入问询阶段,拟募集资金分别约75亿元、50亿元、41.8亿元。

德勤在《2026年中国内地和香港新股市场的中期回顾与展望》中指出,随着科创板改革、创业板第四套上市标准出台,及科创板的

估值进一步上扬,预料会有更多来自硬科技企业和一些具标志性新股上市。

政策持续加码

开市七年,科创板制度供给与政策支持持续加码。作为注册制改革“试验田”,板块持续完善全链条制度体系:落地五套差异化上市标准,打通未盈利企业、红筹企业、特殊股权结构企业上市通道;相继推出“科创板八条”“1+6”深化改革举措,设立科创成长层、拓宽第五套上市标准适用范围,持续提升对前沿科创企业的包容性。

今年6月17日,证监会主席吴清在2026陆家嘴论坛上提出,扩大科创板第五套上市标准适用范围至人工智能领域,积极支持优质人工智能大模型企业登陆科创板;落实发展未来产业战略部署,扶持量子科技、生物制造、具身智能等更多赛道“硬科技”企业上市。

当日,上交所同步发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第10号——人工智能大模型企业适用科创板第五套上市标准》(以下简称《指引》),文件自发布之日起施行。《指引》共计十五条,细化大模型企业适用第五套上市标准的各项条件,明确主营业务范畴为人工智能大模型自主研发、模型服务或模型应用等。

系列改革举措落地之下,智谱、MiniMax推进“A+H”上市进程提速。目前智谱A股IPO辅导状态变更为辅导工作完成;MiniMax已于5月29日正式启动A股IPO辅导。

与此同时,科创板持续优化再融资、并购重组相关规则,完善股权激励机制,丰富科创指数与投资产品;配套推出IPO预先审阅、资深专业机构投资者试点等创新安排,畅通科技企业直接融资渠道。一系列制度创新持续引导资本流向原始创新、关键技术攻关领域。

安永北京主管合伙人杨淑娟表示,依托政策红利与融资环境改善,部分港股上市公司创业企业加速筹划回归A股,以此拓宽融资渠道、提升研发投入能力。

北京商报记者 马换换 李佳雪

扭亏之后,芯迈半导体三战IPO

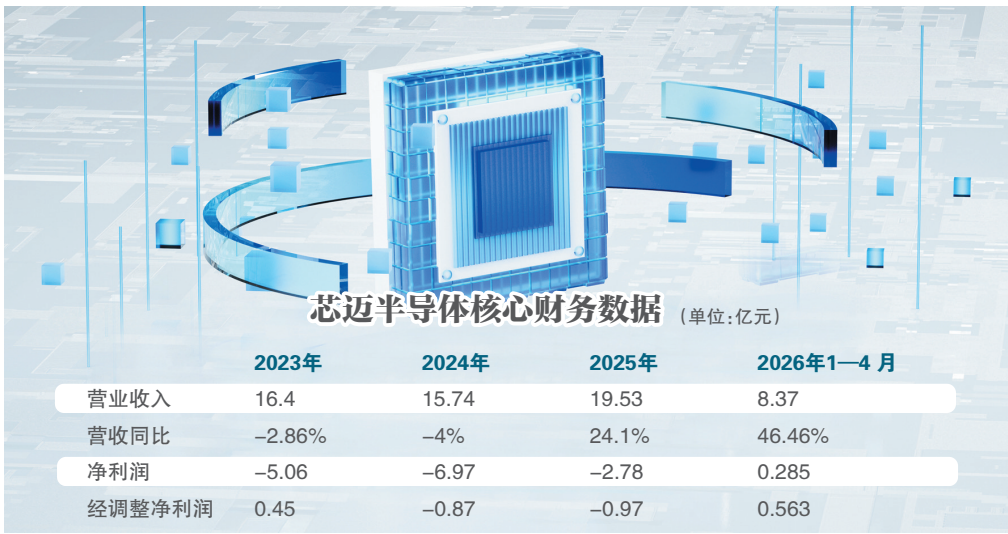
历经三轮融资,集齐红杉、高瓴、小米、“宁王”等一众知名机构的芯迈半导体于7月递表,三度冲击IPO。

港交所官网近日披露,芯迈半导体技术(杭州)股份有限公司已向港交所主板递交上市申请。这是继2025年6月30日、2026年1月7日两次递表失效后,芯迈半导体第三次冲击港股上市。

历经多轮融资,芯迈半导体股东阵容汇集多家知名产业资本与财务投资机构。天眼查股权信息显示,公司A轮融资阶段便引入红杉中国、宁德时代相关投资主体、小米集团旗下湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙),以及高瓴创投旗下珠海巍恒股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州富阳项恒股权投资合伙企业(有限合伙);推进至后续融资阶段,高瓴创投继续追加投资。

芯迈半导体主营功率半导体业务,聚焦电源管理芯片(PMIC)与功率器件研发、销售。功率半导体主要调控电路电压、电流参数,实现电能高效转换与管理,属于各类电子设备核心基础元器件。公司产品布局移动技术、显示技术、功率器件三大方向,下游覆盖多元场景:汽车电子;基站、网络通信设备等电信设施;包含AI服务器在内的数据中心;电机驱动、电池管理系统(BMS)、绿色能源设备、人形机器人等工业领域,以及智能手机、电视等消费电子产品。

受益于汽车电气化、AI算力基础设施建设、工业智能化趋势,功率半导体行业具备长期增长稳定的空间。行业需求由两大板块支撑:消费电子、工业自动化、汽车市场构筑传统需求基本盘,新能源汽车渗透率持续提升成为核心增长动力;AI数据中心、人形机器人等新兴应用场景持续扩容,开辟全新增量空间。



招股书援引弗若斯特沙利文数据显示,2025年全球功率半导体市场规模6345亿元,预计2030年增至8878亿元,年复合增长率6.9%。细分赛道中,2025年全球电源管理芯片(PMIC)市场规模3825亿元,预计2030年达到5614亿元,年复合增长率8%;汽车电子为增速最快赛道,2025年至2030年汽车PMIC市场复合增长率可达10.9%。

从市场占有率来看,芯迈半导体当前行业整体份额仍有待提升。按2025年收入统计,公司全球PMIC市场份额约0.4%;细分领域,在全球消费电子PMIC赛道排名全球第11位,市场份额1.6%;全球MOSFET市场份额为0.1%。

相较于前两次递表,本次申报一大显著变化是,依托行业红利,公司经营状况明显改善,实现阶段性扭亏。

财务数据显示,芯迈半导体营收在2024年短暂回调后重回上行通道。2023年、2024年、2025年营收分别为16.4亿元、15.74亿元、19.53亿元;2026年1至4月营收8.37亿元,对

比2025年同期5.71亿元,同比增长约46.46%。

伴随营收增长,盈利端迎来拐点:2026年前4个月,公司实现净利润2850万元,上年同期净亏损1.59亿元;同期经调整净利润5630万元,上年同期亏损5764万元。在此之前,公司连续三年处于亏损状态,2023年净亏损5.06亿元,2024年净亏损扩大至6.97亿元,2025年亏损收窄至2.78亿元。

北京社科院副研究员王鹏向北京商报记者分析,市场投资逻辑正从概念驱动转向商业落地驱动,大模型应用、智算中心建设催生真实市场需求,规模化商业化应用带动半导体多个细分赛道实现稳步增长。

北京商报记者就相关业务问题咨询芯迈半导体方面,公司相关人士回复称,公司始终将研发置于优先地位并扩大产品应用覆盖范围,尤其在新兴领域(包括电信及计算和汽车电子)已实现产品采用率及出货量的持续增长。

而用业绩解答盈利考题之后,芯迈半导体的上市进程或将再添筹码。

北京商报记者 陶凤 王天逸

侃股 Stock talking

低位的注销式回购更加利好

周科竞

历经阶段性调整之后,A股部分上市公司的股价处于相对低位,此时上市公司掀起一波回购潮。部分公司更是选择回购股份并注销,此操作对股价的利好效应更足,不仅能对公司股价有更好的支撑,同时也能更大程度提升股东价值。

在A股市场调整周期中,股价持续回落让不少上市公司估值回归低位区间。在此背景下,越来越多上市公司启动股份回购计划,其中注销式回购的含金量最高,也是对二级市场最实在的利好。

不同于用于股权激励、员工持股的普通回购,回购注销是直接缩减公司总股本,从基本面和资金面双向改善上市公司投资价值,尤其在股价低位阶段开展操作,利好效果会被进一步放大。

上市公司选择在股价低位进行回购并注销,首先体现出公司对自身经营状况和未来发展的充分信心。敢于真金白银回购股份,说明上市公司现金流稳定、经营基本面健康,不存在经营恶化、债务承压等问题。在市场情绪偏弱、投资者信心不足的阶段,上市公司的真金白银回购,能够有效对冲市场悲观情绪,向市场传递估值偏低、具备配置价值的明确信号。

从资金层面来看,低位回购能够直接为个股提供买盘支撑。市场调整阶段,场内抛压集中,散户恐慌抛售容易引发股价非理性下跌。上市公司此时入

场回购,可以承接部分市场抛压,遏制股价持续下行的态势,稳定二级市场价格走势,避免个股出现超预期的非理性回调。

从股东权益角度分析,低位注销式回购能够切实提升全体股东的权益。总股本缩减后,上市公司的每股收益指标会得到提升,公司整体含金量随之增加。相比高位回购,低位回购的资金利用效率更高,同样的资金可以回购更多股份,注销后对财务指标的优化效果更加明显,长期增厚股东收益。

对于上市公司自身而言,股价处于低位时,公司股票的投资价值高于市场平均水平,此时回购自家股份,是对公司闲置资金的高效利用。这种低位回购的成本优势,远优于高位回购,能够实现更好的回购效率,持续优化公司股本结构,为后续股价修复和长期估值修复打下基础。

部分投资者容易混淆普通回购和注销式回购的区别,单纯回购不注销,股份会以库存股的形式留存,未来存在再次减持、股权激励发放的可能,对市场的利好相对有限。而注销式回购是永久性缩减股本,不存在后续减持套现的压力,利好具备长期性和确定性。

当然,并非所有实施注销式回购的上市公司都具备投资价值。投资者需要甄别回购的资金来源和上市公司基本面,依托自有闲置资金、经营稳健的低位注销式回购,更值得关注。